证券代码：603228　　证券简称：景旺电子　　公告编号:2026-092

深圳市景旺电子股份有限公司
关于投资建设高阶 mSAP 精密线路板项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**高阶mSAP精密线路板项目。
- **投资金额：**预计总投资人民币26.80亿元，将根据项目实际进展分阶段投入，最终以项目建设实际投资开支为准。
- **本次投资交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次投资事项已经董事会审议通过，无需提交股东会审议。
- **相关风险提示：**本项目是在公司目前条件下结合外部市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预估存在差距。项目实施过程中可能会面临宏观经济、行业政策、市场波动等因素影响，可能存在达不到预期效益的风险。本项目的投资金额、建设周期等为预估数，实际建设过程中存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

一、 对外投资概述

（一） 本次投资概况

1、本次投资概况

为顺应人工智能算力产业高速增长趋势，抢抓高端 PCB 市场发展机遇，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）持续扩充 mSAP 先进制程产能，深化与全球头部客户的战略协同，全面提升公司高端 PCB 业务的综合竞争力与盈利能力。经充分的市场调研与审慎论证，公司拟投资建设“高阶 mSAP 精密线

路板项目”（以下简称“该项目”或“本项目”）。

2、 本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 ☑投资新项目 □其他：
投资标的名称	高阶 mSAP 精密线路板项目
投资金额	☑ 已确定，具体金额：人民币 26.80 亿元
出资方式	☑现金 ☑自有资金 ☑其他：自筹资金 □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 ☑否

（二） 董事会审议情况

公司于 2026 年 11 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于投资建设高阶 mSAP 精密线路板项目的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

（一） 投资标的概况

本项目由公司三级全资子公司珠海景泓电子技术有限公司作为实施主体。通过新建高标准洁净生产车间，引进高端全流程生产设备，配套建设公用工程及环保设施，并搭建智能化生产管理系统，实现生产过程的高精度控制与全流程可追溯。项目建成后，将扩充公司高阶 mSAP 电路板生产能力，进一步强化公司在 AI

算力等高端应用领域的产能保障与快速交付能力。

（二）投资标的具体信息

（1）项目基本情况

投资类型	☑投资新项目
项目名称	高阶 mSAP 精密线路板项目
项目主要内容	建设高阶 mSAP 项目，扩充高阶 mSAP 电路板生产能力
建设地点	珠海市斗门区乾务镇富山工业园内
项目总投资金额（亿元）	26.80（最终以项目建设实际投资开支为准）
上市公司投资金额（亿元）	26.80（最终以项目建设实际投资开支为准）
项目建设期（月）	24，分阶段完成设备进场、安装调试、试生产等工作
是否属于主营业务范围	☑是 □否

（2） 各主要投资方出资情况

公司拟通过自有及自筹资金等多种方式筹措本次项目资金。

（3）项目市场定位及可行性分析

随着人工智能算力基础设施建设的加速推进，mSAP 工艺已成为 800G 及 1.6T 光模块 PCB 的主流技术路线，并向 3.2T 光模块等下一代应用场景加速延伸，mSAP 电路板产能需求也急速增长。公司本次拟建设的 mSAP 项目定位于 AI 算力基础设施领域高端 PCB 产品，主要面向 800G、1.6T/3.2T 光模块 PCB 等应用市场。公司已在珠海金湾基地建成 5 条 mSAP 产线，厂房硬件条件、工艺路线及材料供应链均已通过大批量生产验证，本次扩产系成熟工艺的规模化复制，项目具备充分的可行性。

公司深耕 PCB 行业三十余年，与全球头部优质客户合作持续深化，业务关系稳定，研发投入与专利储备雄厚，关键工序配套完整，现金流稳健，可有力支撑高端产能扩张。公司现有 mSAP 产线均处于较高稼动率，现有产能预计无法充分满足客户快速增长的交付需求。本次项目建设是公司抢抓 AI 算力带来的市场窗口期、保障核心客户订单持续稳定交付的现实需要，是优化产品结构、提升高毛利业务占比、增强公司核心竞争力与市场地位的重要举措，亦符合国家电子信

息产业高端化、自主化的发展方向，具有良好的市场前景与经济效益，符合公司及全体股东的利益。

三、 本次对外投资对公司的影响

本项目契合公司纵深推进“1+1+N”的业务布局，有利于公司优化产品结构，扩充高端优质产能，进一步巩固公司在全球高性能 PCB 领域的市场地位，提升公司对全球算力硬件供应链的交付能力与综合竞争力。本次投资资金来源为自有资金及自筹资金等多种方式，公司将根据项目具体需要分期投入投资资金，不会对公司现有业务的正常开展及公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。从长期来看，对公司未来发展和经营收益具有积极推动作用，符合公司长期发展战略规划。

四、 对外投资的风险分析

1、本次投资项目在实施过程中，若宏观经济波动、行业政策调整、市场需求不及预期或产品价格出现波动，下游应用行业技术迭代快、市场竞争激烈，以及工程建设进度、设备采购及安装、工艺调试未达预期，均可能影响产能释放与项目预期效益。本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将组建专业的项目管理团队，制定详细的项目实施计划和应急预案，加强与供应商及承建商等合作伙伴的沟通协调，严格控制项目进度和成本管理，确保项目按计划推进。

2、本次项目投资资金来源包括但不限于自有及自筹资金等多种方式，可能面临一定的资金筹措压力，存在一定的融资风险。公司资信情况良好，银行授信额度充足，没有对公司经营产生重大影响的对外担保。公司将根据项目建设进度和资金需求，与合作厂商充分协商更友好的付款方式，根据需要科学规划融资方案，优化资本结构，合理控制融资成本和财务风险，确保足够的资金投入以满足项目建设需求。

3、本次投资项目的投资金额、建设周期等为预估数，实际建设过程中存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日